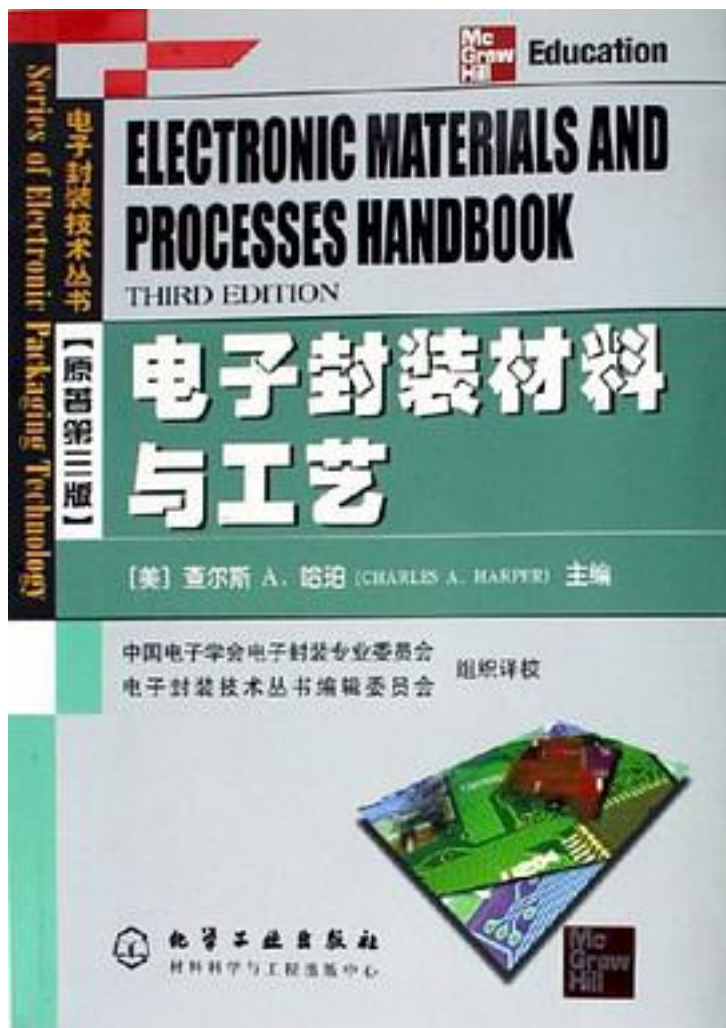


电子封装材料与工艺



[电子封装材料与工艺_下载链接1](#)

著者:查尔斯A.哈珀

出版者:化学工业出版社

出版时间:2006-3

装帧:

isbn:9787502579791

本书由工作在电子封装第一线的各方面专家编写，内容涉及电子封装及相关领域的材料

与工艺，包括半导体、塑料、橡胶、复合材料、陶瓷和玻璃以及金属等各种材料，也包括电子封装和组装的软钎焊、电镀与沉积金属涂层、印制电路板制造、混合微电路与多芯片模块的材料和工艺、电子组件中的粘接剂、下填料和涂层以及热管理材料及系统等各种工艺技术，较充分反映了当前电子封装各方面的先进材料与工艺，不仅理论分析充分，而且有丰富的实践经验总结，是关于电子封装材料和工艺的较为全面而实用的工具书。本书对从事电子封装及相关行业的科研、生产、应用工作者都会有较高的使用价值，对高等院校相关专业的师生也具有一定的参考价值。

作者介绍:

目录:

[电子封装材料与工艺_下载链接1](#)

标签

考试学习

钨铜

设计

工业设计,毕业设计

评论

一点用都木有……基本没怎么讲聚合物材料……总算是把这篇论文弄完了，虽然回头看还是修为不够文章写的太水了一点，但是无论成绩好坏和专业再见前还能听到这样一门课无遗憾了。

[电子封装材料与工艺_下载链接1](#)

书评

[电子封装材料与工艺_下载链接1](#)